

第71回型技術セミナー

戦略的基盤技術力強化事業 I

—プレス関連—

- ◆ 開催日時：2005年7月14日（木）10：00～16：45
- ◆ 開催場所：工学院大学 新宿校舎 28階第1・2会議室
〒163-8677 新宿区西新宿1-24-2 TEL 03-3342-1211(代表)
- ◆ 主催：型技術協会
- ◆ 趣旨：

戦略的基盤技術力強化事業が平成15年度から3年間の期間で実施されています。中小企業庁から中小企業基盤整備機構への委託で金型部門では15テーマ採択されています。この中では多くの中小企業が参画して先端的な型技術を開発しています。金型企業の目指すべき方向性の一つに技術力の強化が挙げられており、このような国家プロジェクトに中小企業が2/3以上参加して新たな技術を切り拓いているのは喜ばしいことです。

本セミナーでは15テーマの中から主にプレス関連金型に絞って、現在開発中の新たな型技術や加工技術に関して紹介していただき、技術的指向についてヒントが得られるよう企画しました。

この機会に、講演者との有意義な討論を通して、技術力を深めていただけることを願っています。

興味のある会員の皆様には是非奮ってご参加下さい。

- ◆ 講演者（講演順）

開会挨拶

司会：鈴木裕氏（九州工業大学）、安斎正博氏（(独)理化学研究所）

- 10：00～11：00 『金属材料による微小電子機械(MEMS)の一体成形技術に関する研究』
東京都立大学 楊明氏
- 11：00～12：00 『ナノ表面構造化による高品位Mgプレス成形金型の長寿命化に関する研究開発』
大阪府立大学 東健司氏
- 12：00～13：00 昼食
- 13：00～14：00 『難加工マグネシウム合金大型板材の高効率量産プレス成形金型に関する研究開発』
長岡技術科学大学 鎌土重晴氏
- 14：00～15：00 『個別機械対応次世代型合わせ技術に関する研究開発』
(株)宮津製作所 津久井伸一氏
- 15：00～15：15 休憩
- 15：15～16：15 『光学ガラス素子用超精密金型設計・製造技術の確立』
三津江金型(株) 福田達也氏
- 16：15～16：45 『戦略的基盤技術力強化事業中間報告総括』
九州工業大学 鈴木裕氏

参加費 : 会 員 20,000 円 (型技術協会 正・法人会員) 1,000 円 (型技術協会 学生会員)
 一 般 30,000 円 ※ いずれもテキスト1冊を含む

◆定 員 : 80名 (申込順で定員になり次第締切ります)

◆申込締切: 2005年7月6日 (水)

◆申込方法: 下記の「第71回型技術セミナー申込書」にご記入の上、FAX またはホームページよりオンライン申込ください。お申込の場合は、代金の振込方法を申込書に記入し、振込日をご記入下さい。当日現金払いは避け、できるだけ銀行または郵便振替にてご入金下さい。

振込銀行 三井住友銀行 三田通支店 普通預金 No. 7813068 型技術協会
 郵便振替 No. 00160 - 1 - 35639 振込手数料は各自でご負担願います。

◆申込先: 型技術協会

〒231-0011 横浜市中区太田町6-79 マスミューチュアル生命横浜ビル201号室

電話: 045-224-6081 FAX: 045-224-6082

Eメール: info@jsdmt.jp ホームページ http://www.jsdmt.jp/

- ◆ご注意: 1) 参加決定者には参加券をお送り致します。当日参加券と引換テキストをお渡し致しますのでご持参下さい。
 2) 参加費は開催日以前に入金されるようお願い致します。
 3) 参加費納入後取消の申出が有りましたが返金致しません。ご了承下さい。その場合テキストはお送り致します。
 4) 車でのご来場はご遠慮下さい。

キリトリ

FAX 045-224-6082

型技術協会行

第71回型技術セミナー申込書

「戦略的基盤技術力強化事業 I」

会社名:	
住所: 〒	
電話: ()	
FAX: ()	
E-mail:	
参加者氏名 (1)	参加者氏名 (2)
所属部署	所属部署
連絡者名 (参加者と同じ場合は記入不要)	会員の有無: 会員 (No.)
所属部署	(○印) 非会員
送金額: 円也	
入金方法 (○印): 銀行振込 ・ 郵便振替 ・ 現金	
入金予定日 : 月 日 (銀行振込・郵便振替の場合は原則として領収書を発行しません)	
請求書の必要 : 有	
(○印) 無	